

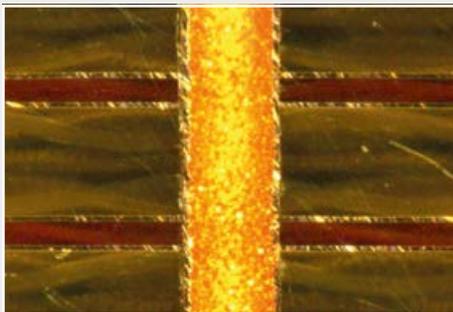
Zuverlässige Durchkontaktierung im Labor

LPKF Contac S4

- Gleichmäßiger Aufbau der Kupferschicht
- Einfache Bedienung
- Microvia-Reinigungsschritt
- Optionale Verzinnung



Sichere Durchkontaktierung im Entwicklungslabor



Nicht nur doppelseitige Leiterplatten, sondern auch Multilayer werden von der LPKF Contac S4 zuverlässig und gleichmäßig durchkontaktiert.

LPKF

Durchkontaktierung für Labore – LPKF Contac S4 für einen zuverlässigen galvanischen Prozess

Zuverlässige Durchkontaktierung ist ein Schlüssel zum Erfolg bei anspruchsvollen Leiterplatten-Prototypen. Die neue LPKF Contac S4 vereint verschiedene galvanische und chemische Prozesse in einem kompakten Sicherheitsgehäuse.

Galvanische Durchkontaktierung

Die Verbindung zweier oder mehrerer Lagen ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Leiterplatten-Prototypings. Die kompakte LPKF Contac S4 mit sechs Bädern übernimmt diese Aufgabe zuverlässig: Die Platine wird durch alle Stufen einer Bäderekaskade geleitet. Auf diese Weise werden homogene Kupferlagen auf den Wandungen aller Durchgangslöcher erzeugt, selbst bei mehrlagigen Platinen. Die Contac S4 bearbeitet bis zu acht Lagen mit einem maximalen Seitenverhältnis von 1:10 (Durchmesser der Bohrung zu Dicke der Leiterplatte). Die LPKF Contac S4 bietet ein abschließendes Zinnbad zum Schutz der Oberfläche und zur Verbesserung der Lötbarkeit.

Verbesserter Aufbau der Kupferschicht

Die leistungsstarke Technik der LPKF Contac S4 verbessert den Aufbau der Kupferschicht. Optimierte Anodenplatten und Reverse Pulse Plating stellen eine gleichmäßige Abscheidung sicher, und die Aktivierung

mittels Black-Hole-Technologie, eine integrierte Luftströmung und ein zusätzlicher Prozessschritt zur Reinigung der Durchgangslöcher sorgen sichere Anschlüsse an das Oberflächenkupfer ohne störende Trennschichten. Das Ergebnis sind gleichmäßige Schichtdicken in den Bohrungen und auf der flachen Metalloberfläche des Substrats.

Einfache Anwendung

Das integrierte Touch-Bedienfeld führt auch unerfahrene Anwender mit einem Assistenten und einer Parameterverwaltung sicher durch den Galvanisierungsprozess. Ambitionierte Entwickler können jederzeit angepasste Einstellungen verwenden. Für den Prozess sind keine Chemikalienkenntnisse und Badanalysen erforderlich, das System weist selbständig auf notwendige Wartungsschritte hin. Ein weiteres neues Merkmal ist das chemikalienbeständige Gehäuse – hohe Funktionalität, gutes Aussehen und Praxistauglichkeit kommen in der Contac S4 zusammen.

LPKF Contac S4

Max. Materialgröße (X x Y)	330 mm x 230 mm (13" x 9,1")
Max. Layoutbereich (X x Y)	300 mm x 200 mm (11,8" x 7,9")
Reverse Pulse Plating	Einstellbar
Toleranz	± 2 µm (0,08 Mil), Kupferbeschichtung
Minimaler Bohrungsdurchmesser	≥ 0,2 mm (8 Mil)
Via-Reiniger	Integriert
Chemische Verzinnung	Integriert
Prozesszeit	ca. 90 – 120 min
Stromversorgung	90 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,6 kW
Abmessungen (B x H x T)	856 mm x 446 mm x 542 mm (33,7" x 17,7" x 21,3")

Überreicht durch:

